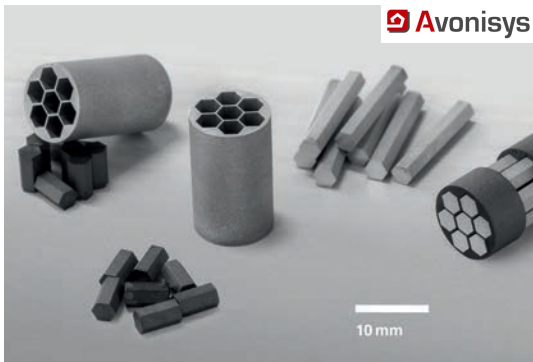


clean CUTTING

SITEC



洁净切割 相对于传统的激光切割和打孔技术，“SITEC洁净切割”的水刀引导式激光具有明显的优势。洁净切割过程类似于对材料进行腐蚀。

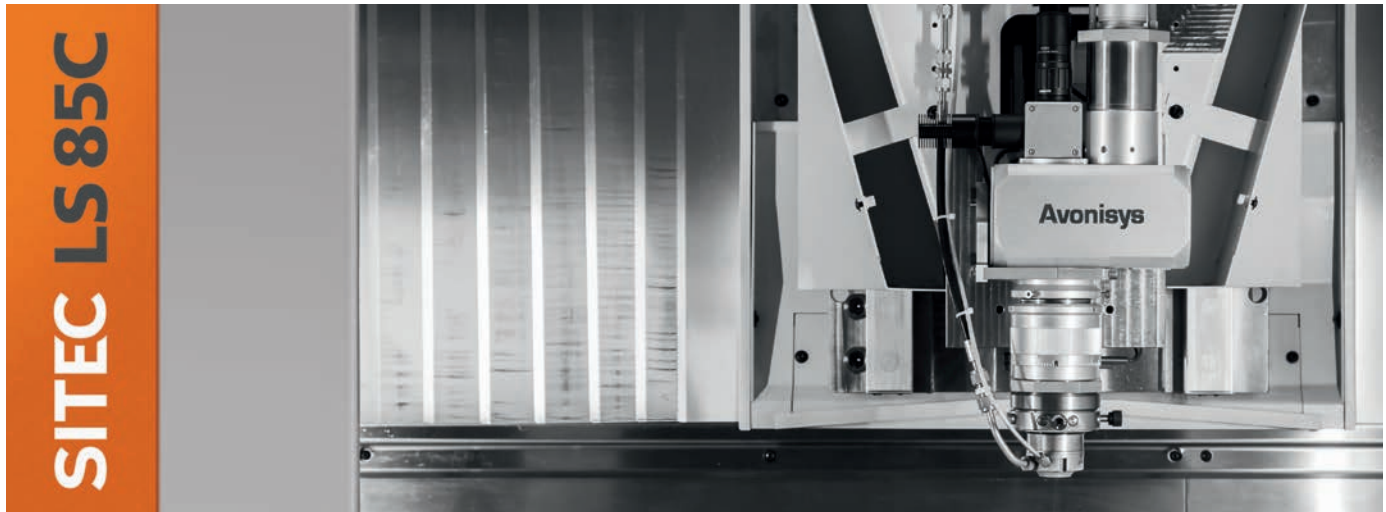
- 过程优势**
- 出色的切削刃
 - 非常薄的薄片和箔的无毛刺激光切割
 - 无毛刺，切割边缘与工件完全平行，根据不同的材料，最大可以切割20mm厚的工件。
 - 减少热量输入
 - 孔可以达到非常高的长宽比

SITEC解决方案 AVONISYS进一步开发了水刀引导式激光切割的著名工艺并优化了服务范围。AVONISYS与SITEC的合作实现了技术的整体系统解决方案和广泛的自动化CNC加工系统。

AVONISYS的模块化系统包括水处理，光束整形和处理光学器件，已成功与现有的LS系列激光机结合使用。

标准化且易于维护的解决方案也可以集成集成到SITEC的任何自动化和定制激光机中。原则上，来自不同激光源制造商的大量固态激光器可以整合到该过程中。由于它的可靠性和低成本，光纤激光器为首选推荐。

批量生产 另外，SITEC还可以在其内部厂房为您提供爬坡生产或批量生产。SITEC质量符合ISO9001和IATF16949标准。



生产解决方案



标准化激光机

- LS系列激光标准机
- 西门子控制系统
- OEM激光源
- 水处理
- 光束整形和加工光学器件
- 手动或自动上料
- 定制的夹具方案
- 占地空间小
- 交货时间短

如您一般灵活!



全自动激光机

- 自动化的激光机，
同时可做集成解决方案
- 西门子控制系统
- OEM激光源
- 水处理
- 光束整形和加工光学器件
- 手动或自动上料
- 定制的夹具方案
- VARIOVIEW®追溯系统

像您一样专注!